



股票代號
6525



捷敏股份有限公司
GEM Services, Inc.

法人說明會
2023/05/22



免責聲明

本次法說會所提供之簡報內容包括對於未來狀況之預測與評估之陳述，乃基於公司目前可得資料之概略說明，其涉及風險及不確定性，並可能發生實際結果與預期狀況有重大差異的情形，提醒各位不要依賴這些資訊，另除非法律要求本公司將不負責更新或公告這些預測的結果。

簡報內容

- 公司概况
- 營運概況
- 財務概況
- 未來展望
- Q&A

公司概況

創立

- 成立於1998年

產能

- 77億顆年封測產能

特別技術

- Multi-chip Module (多晶粒模組)
- J-lead Wide Body (內彎腳型封裝)
- Leadless (底部貼焊型)
- Bond-wireless(非鉚線結構):
Flip chip, Cu Clipper

終端應用

- 電腦, 手機, 手持電子產品
- LCD / 電漿顯示器
- 家電產品

員工

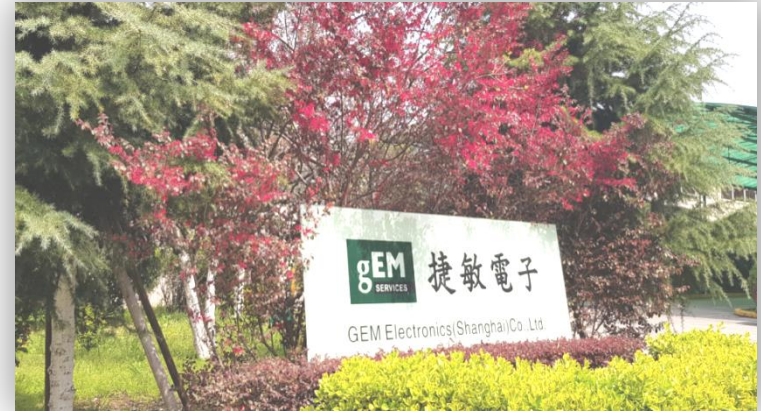
- 員工人數: 2,000+ (技術人員: 550+)

營運據點

- 總部: 台灣新北市中和區

主要股東

- 聯鈞光電股份有限公司 (持股51%)



- 工業電子系統
- 電動車/車載電子

- 上海廠: 中國上海市嘉定區
- 合肥廠: 中國安徽省合肥市



- 土地面積: 19,000 平方公尺 (租賃)
- 建築佔地面積: 15,400 平方公尺
- 樓地板面積: 17,836 平方公尺



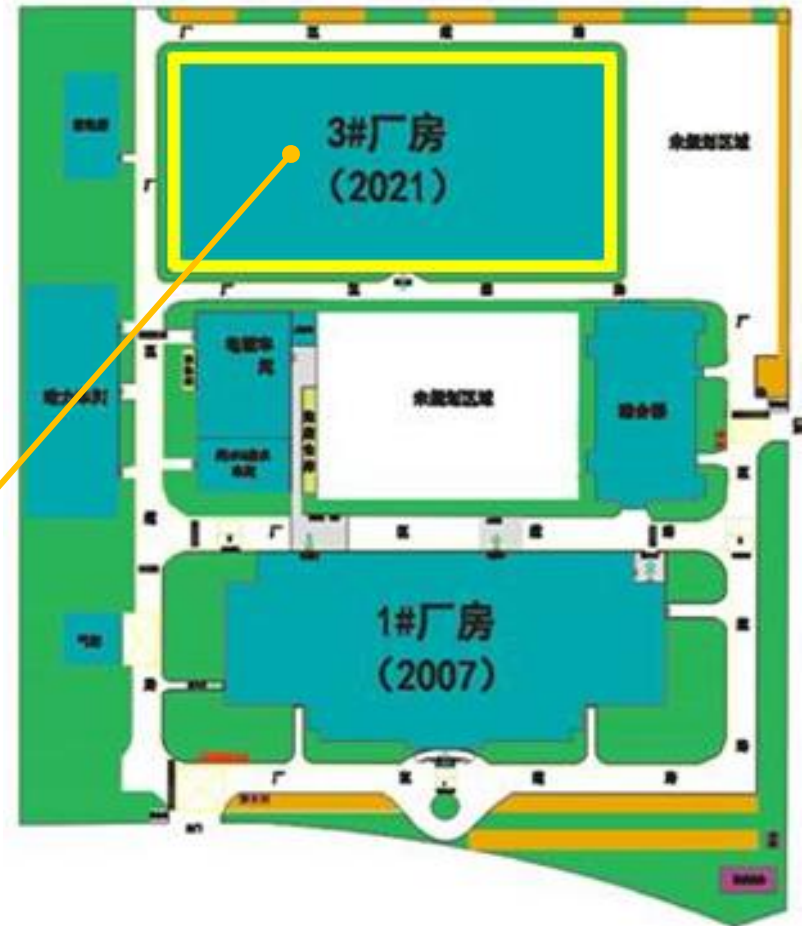
Bd#1

- 土地面積: 69,812平方公尺 (自有)
- 合肥舊廠房 (Bd#1)
 建築佔地面積: 17,920平方公尺
 樓地板面積: 28,588平方公尺
- 合肥新廠房 (Bd#3)
 建築佔地面積: +10,368平方公尺
 樓地板面積: +39,096平方公尺



Bd#3

厂区布局图



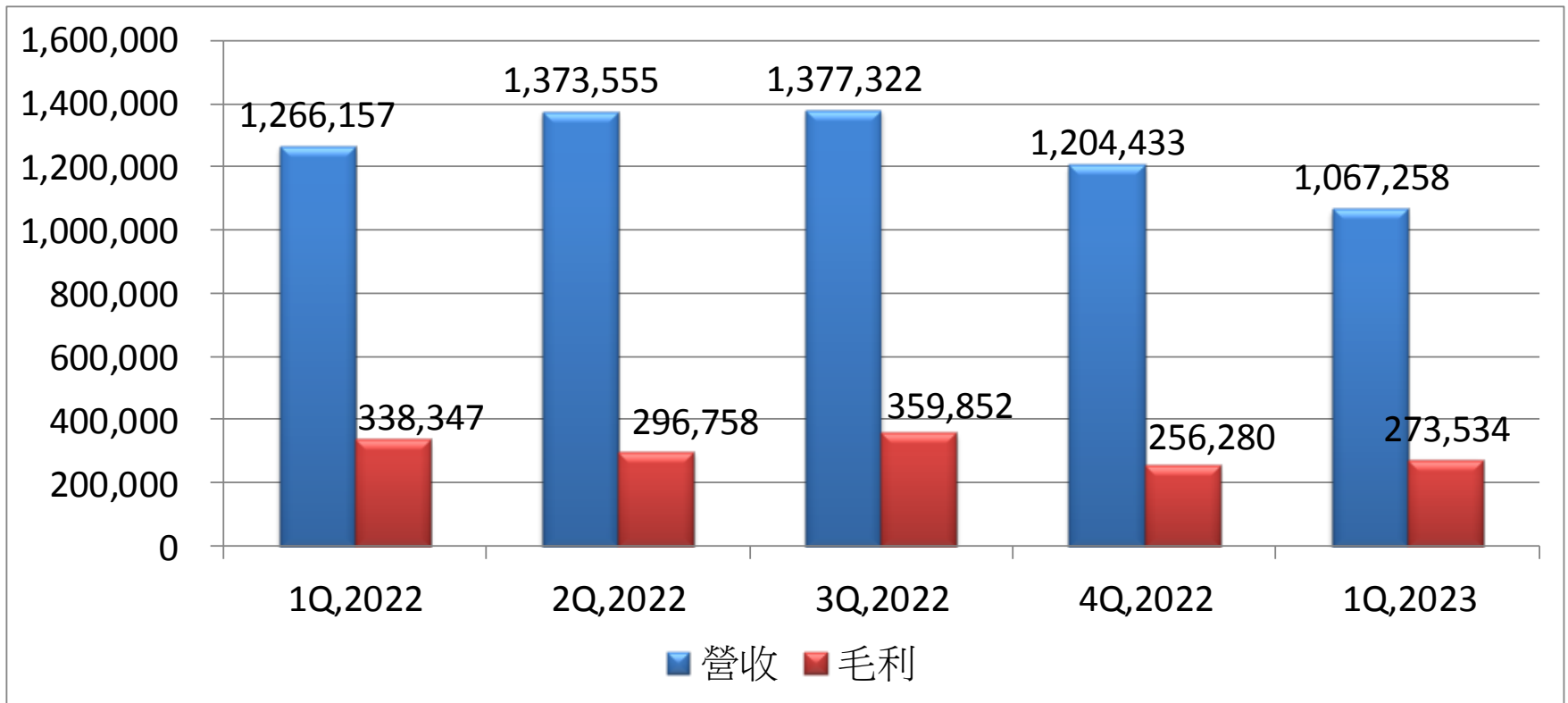
- 提供 高低壓功率金氧半場效電晶體(Power MOSFET)、絕緣柵雙級型電晶體(IGBT)、二極體(Diode)及電源轉換或電源管理 IC (Power Management ICs)、功率模組等之封裝與測試服務
- 主要應用於 通訊、電腦/筆電主機板及周邊產品、家電消費性電子產品, 以及任何需要電力系統供其運轉之車用電子及工業用設備機具應用等



營運概況

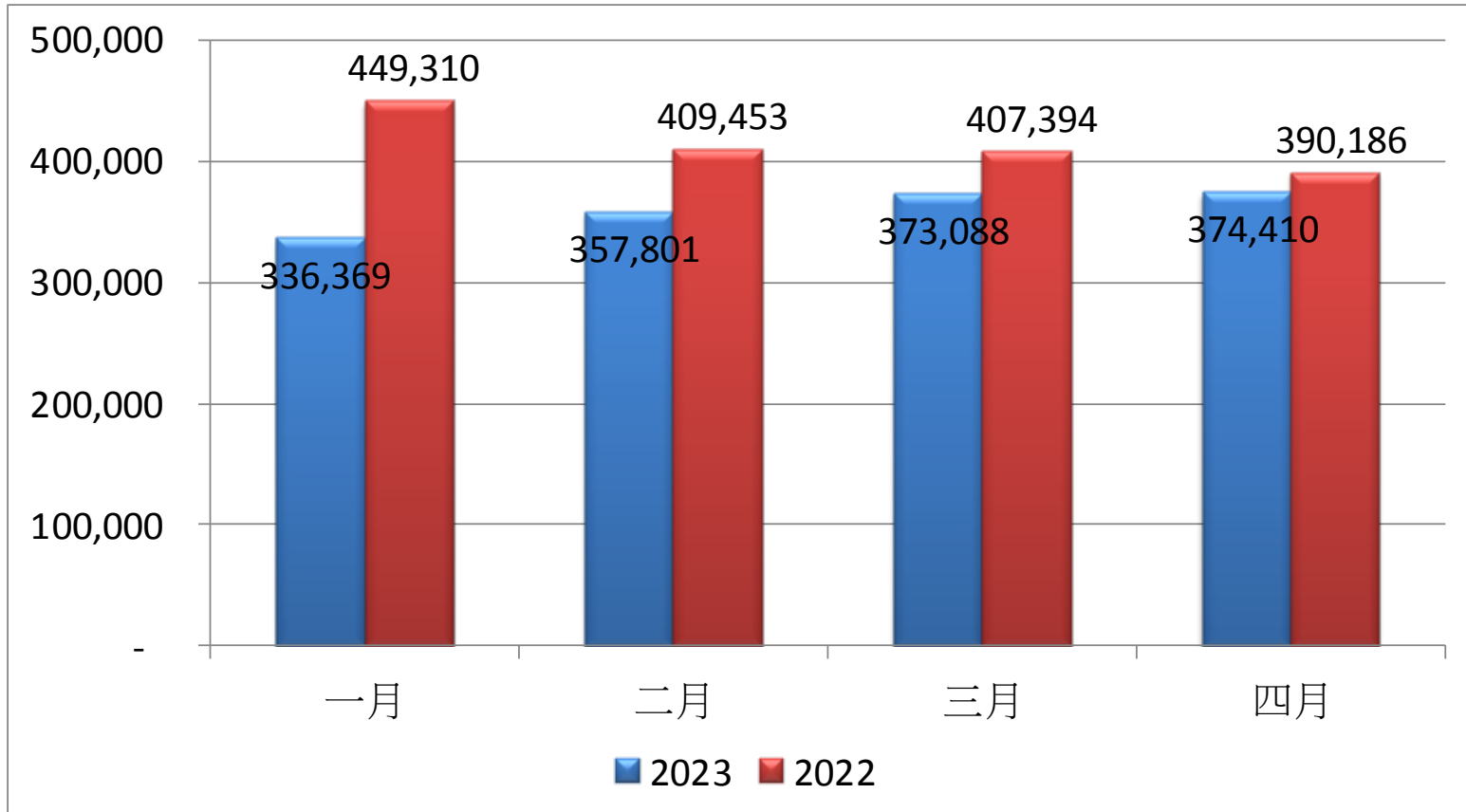
合併營收與毛利

新台幣：仟元



2023年各月份合併營收

新台幣：仟元



合併損益表

	2023年第1季		2022年第1季	
	金額	%	金額	%
營業收入	1,067,258	100%	1,266,157	100%
營業毛利	273,534	26%	338,347	27%
營業費用	74,036	7%	93,664	7%
營業淨利	199,498	19%	244,683	19%
營業外(損)益	1,707	0%	67,873	5%
稅前淨利	201,205	19%	312,556	25%
所得稅費用	41,263	4%	59,868	5%
本期淨利	159,942	15%	252,688	20%
EPS(元)	1.24	-	1.96	-

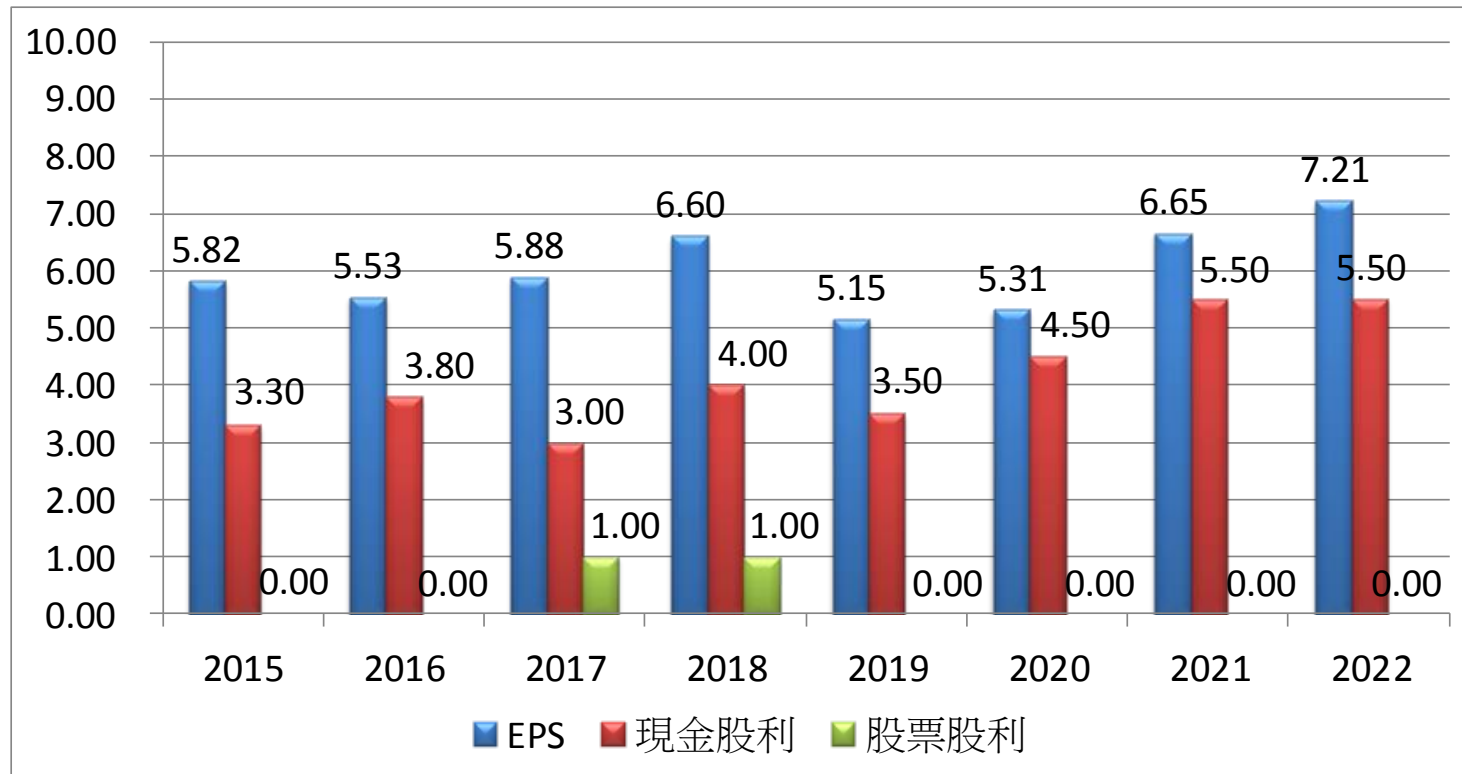
合併資產負債表

	單位：新台幣仟元		
	2023年第1季	2022年第4季	2022年第1季
現金及約當現金	2,039,206	1,973,637	1,925,398
應收款項	780,552	832,607	960,405
存貨	202,569	200,519	422,054
流動資產合計	3,315,214	3,279,230	3,666,196
不動產廠房設備	3,222,306	2,914,089	2,691,869
非流動資產合計	3,566,950	3,651,545	3,546,476
資產總計	6,882,164	6,930,775	7,212,672
應付帳款	594,940	678,568	898,173
流動負債合計	2,507,539	1,991,013	2,884,651
非流動負債合計	584,099	595,953	586,246
負債總計	3,091,638	2,586,966	3,470,897
普通股股本	1,290,474	1,290,474	1,290,474
資本公積	624,536	624,536	624,536
保留盈餘	2,088,017	2,637,836	1,960,201
其他權益	(212,501)	(209,037)	(133,436)
權益總計	3,790,526	4,343,809	3,741,775
負債比率	44.92%	37.33%	48.12%
流動比率	132.21%	164.70%	127.09%
本公司每股淨值（元）	29.37	33.66	29.00

合併現金流量表

	單位：新台幣仟元	
	2023年第1季	2022年第1季
營業活動淨現金流入(出)	241,711	417,282
投資活動淨現金流入(出)	(165,141)	(262,978)
籌資活動淨現金流入(出)	(1,136)	44,454
匯率變動影響	(9,865)	73,991
現金及約當現金淨增(減)	65,569	272,749
期初現金及約當現金餘額	1,973,637	1,652,649
期末現金及約當現金餘額	2,039,206	1,925,398

單位：新台幣元



- 提升合肥廠產能，目前中低壓及高電壓產品開發與生產並行，另考量產品業務發展方向做計劃性之擴充。
- 持續高附加價值，以及第三代半導體相關產品之開發。
 - * SiC分離器件:持續開發1200V以上高功率產品的封裝及測試。
 - * SiC 模塊:整合客戶需求擬定產品共同開發計劃。
- 5G、工業用及車用產品市場仍是發展重點。
 - * 依電源轉換總成散熱冷卻系統需要，開發高功率元件與散熱面(Top EP cooling)整合之系列產品。

Q&A

謝謝

